

令和6年度 京都実装技術研究会オープニングセミナーの開催について

令和6年5月8日
京都府中小企業技術センター
担当: 応用技術課
電話: 075-315-8634

京都府中小企業技術センターでは、電子機器の生産に深く関わる技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマとして、その解決を目的とした「京都実装技術研究会」を設置しています。

この度令和6度の会員を募集するため、オープニングセミナーを以下のとおり開催します。

- 1 日 時 令和6年6月7日（金） 14:00～17:00
- 2 開催方式 会場参加/Web(zoom) 併用（講師は会場でのご講演です）
- 3 会 場 京都府産業支援センター 5階 研修室
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）
- 4 内 容 「世界の半導体市況と日本のあるべき姿」
講師 おおやま さとる 大山 聡 氏/グロスバーグ合同会社 代表

半導体産業は今では多くの国や地域が「重要産業」と位置付け、戦略的に支援を行っている。最先端分野では米国が対中規制を強化する中、車載やパワー関連では欧州が中国との連携を強化するなど、様々な動きが見られる。日本政府も半導体産業の活性化に積極的だが、日系デバイスメーカーが弱体化しているため、外資に頼らざるを得ない政策となっている。

そのような背景を踏まえ、日本の半導体産業のあるべき姿について検討してみたい。

- 5 定 員 会場：40名 Web：40名
- 6 参加費 無 料
- 7 申込締切 令和6年6月5日（水）まで
- 8 申込先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp
※ホームページ(<https://www.kptc.jp/>)からも申込みができます。

